

無電解金めっきライン

加工ライン	品目(最表層外観)	めっき厚 μm	加工寸法(mm)				金純度(%)	めっきラインの特徴
			厚さ		サイズ			
			最小	最大	最小	最大		
手動	薄付け及び厚付け金	Au 0.03~0.4 / Ni 3~8	0.05	5	50*150	410*520	99.9	金・アルミワイヤーボンディング可能 狭ピッチ対応(ピッチ20 μm)
	ニッケル/パラジウム/金	Au 0.03~0.1/ Pd 0.05~0.1 / Ni 3~8						金・アルミワイヤーボンディング可能
	ニッケルレス金めっき	Au0.05~ 0.1 / Pd 0.03~0.2						非磁性・ニッケルレス
自動1号	薄付け金 (アルミベース基板対応)	Au 0.03~0.1/ Ni 3~8	0.2	100*150	510*610	アルミワイヤーボンディング可能 高耐食性ニッケル		
自動2号	薄付け金 (大型基板対応)					0.1		510*710



無電解ニッパラ金めっき手動ライン



無電解金めっき自動1号機



無電解金めっき自動2号機



コンベア純水・洗浄装置3号機